

## 有机硅压敏胶 RH-SPS-8067

### 产品介绍

RH-SPS-8067是一种中高剥离强度的加成型固化有机硅压敏胶，具有低迁移性、粘接力稳定、耐湿、耐热和耐候性好等特点。RH-SPS-8067在使用过程中可以快速固化，一步固化成型，比传统的固化方式更节省能源；固化过程中无低分子物质析出，流平性好，薄层涂布的胶面美观；固化后透明度高，电气绝缘性优良。

### 用途

本产品主要用于光学屏幕保护，可适用于PET\PE\PC\PP 等基材。

### 典型性能指标

序号	项目	单位	技术指标	检测标准
1	外观	/	无色透明流动液体，无杂质	目测
2	固含量	%	63±1	GB/T 1725
3	粘度	mPa·s	20000~40000	GB/T 10247
4	密度	g/cm <sup>3</sup>	0.91-0.97	GB/T 4472
5	180°钢板剥离力	g/25mm	600~800	GB/T 2792
6	透光率	%	≥93	GB/T 2410
7	折光率	/	1.41	GB/T 6488

注：基材：50μmPET 膜（电晕处理）

涂胶厚度：20±2μm

### 推荐使用比例

有机硅压敏胶需要配合交联剂、锚固剂、催化剂使用。交联剂在催化剂的催化作用下，和主胶料发生加成反应固化成胶膜，而锚固剂的作用主要是调整胶膜和基材的粘接力，推荐使用比例如下：

RH-SPS-8067：交联剂 XL38：锚固剂 M7：催化剂 Pt5000  
= 100 : 0.8~1.2：0.8~1.0：0.6~1.0



交联剂添加量大，对于厚层胶膜来说，可以起到防溢胶的作用，但若过量，则可能造成交联过度，胶膜硬度偏高，初粘力下降；在一定程度上，降低交联剂可以适当提高剥离力，但过低可能会导致胶体强度偏低。

锚固剂添加量大，对胶膜的粘接力有帮助，但若过量，有小分子析出的风险。

催化剂添加量大，可以降低固化温度及提高固化速度，但若过量，可能造成胶膜硬度变大、可使用时间缩短及成本升高。

## 工艺

配胶：根据事先确定的配比，先将RH-SPS-8067和其他剥离力的压敏胶（如有需要）加入搅拌桶中，然后加入稀释剂（一般稀释至固含量在25~35%），搅拌20~40min，待充分混合均匀后，加入交联剂XL38，搅拌3~5min；再加入锚固剂M7，搅拌3~5min；最后加入催化剂Pt5000，搅拌均匀后（一般为30min左右）即可涂覆。稀释剂可根据具体情况调整。

实验室涂布工艺：150℃条件下2-3分钟烘烤即可。

生产涂布工艺：烤箱温度设定为90-160℃,烘烤时间和温度是依据涂布量来调整，当涂布的胶膜厚度在10um时，胶水的烘烤时间应控制在50-60s；当涂布的干胶厚度在20um时，胶水的烘烤时间应控制在80-90s为宜，若催化剂的添加量大，同时相应减少烘烤时间和温度，但可能对胶膜硬度和成本略有影响，请根据具体设备和工艺调整。

典型的涂布固化条件：当涂布的胶膜厚度在20um时，生产线速度可控制在10-16m/min，烘道温度设定为依次从90℃到160℃再到100℃,烘道长度为24米。

## 使用方法及其注意事项

胶料中有挥发性溶剂，使用时务必保证环境通风良好，并远离火种及高温；

使用中配戴好防护用品，避免与皮肤接触，一旦接触皮肤后应及时用肥皂、流动清水冲洗干净；

涂布必须在适合的环境下进行，建议操作间采用无尘处理、温度控制在25~35℃，湿度控制在15~60%。粉尘过多会导致涂布成品有颗粒污点、不良率上升。温度过低会致使流平不佳、附着力下降。

湿度过高易造成涂膜缩孔，湿度过低易造成静电安全隐患，出现表面泛白现象。

## 包装、储存和运输



本产品常规包装有180kg/桶，也可根据用户指定更换产品包装。

本产品在阴凉干燥处避光保存，运输及储存过程应避免日晒雨淋，建议储存温度5-25℃。

产品有效贮存期12个月，超期复验，若符合标准，仍可使用。

## 安全与环保（注意事项）

操作时，请注意操作环境通风良好，并按要求佩戴个人防护用品，保持良好的防护措施。使用后的包装物，请按一般固体废弃物处理。

## 声明

本文所载是我公司认为可靠的资料，该产品说明中的数据为非标准值。记载的内容、产品性能改良、产品规格等在没有预告的情况下可能会有所变更。

我公司只对产品是否符合规格给予保证，在使用时，一定要先进行测试，确认适合您使用目的产品。

本公司的产品是面向一般工业用途而开发。如要作为其它用途，必须按照相关的法律要求做出检测并符合要求，方可使用。

